



H2350 全烧结型低温烧结银浆

H2350 是一款全烧结型低温无压烧结银浆，适用于高功率封装中的芯片互连应用。它形成了一个高度可靠的接头，具有优异的导热性，适用于IGBT 和 SiC 封装工艺。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	热塑性树脂
外观	土黄色膏状物
组分	单组分
固化方式	无压烧结
应用	芯片粘接
典型的产品应用	IGBT 芯片封装

产品优点

- 低体积电阻率
- 高导热导电系数
- 无压烧结工艺
- 优异的界面可靠性

常规性能指标

烧结前性能

	项目	测试方法	测量值
银浆性能指标 (烧结前)	粘度@5s-1,25℃	ASTM D2556-14(2018)	100-120 Pa·s
	触变系数 @25℃,(0.5s-1/5s-1)	ASTM D2556-14(2018)	7.5±1
	非挥发份	ASTM D2556-14(2018)	>90%

烧结后性能

	项目	测试方法	测量值
--	----	------	-----



银浆性能指标 (烧结后)	密度	排水法	$9.0 \pm 0.3 \text{ g/cm}^3$
	体积电阻率	四线法	$< 4.0 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$
	导热系数	闪光法	$> 200 \text{ W/m.k}$
	芯片推力强度(芯片背金) 2.5mmx2.5mm (Ag,Au 素材)	推力机测试	Au:>60 MPa Ag:>60MPa

应用

- IGBT,SIC 封装工艺
- 替代焊料

工艺指南

工艺方法：点胶或者印刷以下

是点胶推荐参数：

条目	参数值
点胶设备	时间-压力控制型
针头尺寸	ID=0.5mm (建议尺寸 0.20-0.60mm)
空气压力	0.7bar

以下是钢板印刷推荐参数

条目	参数值
刮胶硬度	65-75A (Shaw hardness 邵氏硬度)
网目尺寸	钢网 50 μm 厚度
刮刀角度	45°
刮刀速度	20-80 mm/s
推荐膜厚(烧结后)	25-35 μm

常规烧结参数：

条目	参数值
温度/时间	25-170°C/30min; 170°C/10min; 170-250°C/15min; 250°C/60min;



i. 时间公差 ± 3 分钟

ii. 温度公差 $\pm 3^{\circ}\text{C}$

以上烧结条件仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

可以粘接的界面

贵金属如金、银表面

使用说明

在使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开铝箔包装(建议回温时间大于 4 小时)。

银浆对湿度敏感，请不要将银浆长时间暴露在空气中，建议使用环境相对湿度低于 60%，回温次数不超过三次。

本品在 25°C ，相对湿度 $<60\%$ 的条件下，使用期是 3 天。

未用完的胶，请先放入塑料袋内密封后再放入冰箱贮存。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装

- 10ml，30ml / 支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件： -20°C ，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一



特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com